



广东超华科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二〇年十月

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产10000吨高精度超薄锂电铜箔建设项目	75,000.00	71,595.00
2	年产600万张高端芯板项目	37,566.00	32,540.00
3	年产700万平方米FCCL项目	26,575.29	22,296.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	53,569.00	53,569.00
合计		192,710.29	180,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，在最终确定的本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）年产 10000 吨高精度超薄锂电铜箔建设项目

1、项目概况

公司拟投资建设年产 20000 吨高精度超薄锂电铜箔（一期）项目，即年产 10000 吨高精度超薄锂电铜箔项目。本项目位于梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园内，为新建项目，项目总投资 75,000 万元。通过实施本项目，公司将新增年产量 10000 吨的高精度超薄锂电铜箔材料产能，提升核心竞争力。

2、项目实施的背景和必要性

（1）新能源汽车产业推动锂电铜箔市场需求高增长

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新能源汽车成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进经济持续增长的重要引擎。根据高工产研锂电研

究所（GGII）数据，全球新能源汽车销量由 2015 年的 54.6 万辆增至 2019 年的 221 万辆，年均复合增长率为 41.8%，渗透率达到 2.5%，具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。

新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，受到国家政策的大力支持，进入加速发展阶段。目前，我国新能源汽车产销量、保有量连续四年居世界首位，电动化跻身世界前列。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由 2015 年的 33.1 万辆增至 2019 年的 120.6 万辆，复合增长率达 38%，渗透率达到 4.7%。根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年我国新能源汽车新车销量占比将达到 25%，到 2035 年我国新能源汽车新车销量占比将达到 40%，新能源汽车市场发展空间广阔。

新能源汽车产业作为锂离子电池的主要应用领域，极大促进了锂离子电池及锂电铜箔产业的发展。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2018 年中国锂电池出货量达 102GWh，预计到 2023 年出货量将突破 380GWh，预计年复合增长率为 30.6%，将保持快速增长趋势。

锂电铜箔是锂离子电池负极材料集流体的首选材料，系新能源汽车产业中不可或缺的一环，随着新能源汽车产业的快速发展，锂电铜箔市场将处于高速发展的阶段。根据 EV Tank 发布《中国铜箔行业发展白皮书（2020 年）》，2019 年全球锂电铜箔产能为 29 万吨，预计到 2022 年全球锂电铜箔产能将达到 48.8 万吨。

（2）储能市场迅猛发展，未来锂电铜箔市场需求进一步扩大

全球储能市场迅猛发展，储能领域或将成为锂电铜箔另一片蓝海。根据国际能源署（IEA）统计数据，2018 年当年全球新增储能装置功率达 3.1GW，比 2017 年大幅增长 94%；根据 Bloomberg NEF 对全球累计储能装置装机量的预测，全球储能装置总功率将由 2018 年的 9GW 迅猛发展至 2040 年的 1095GW，年复合同比增速将高达 24%，储能市场将拉动锂电铜箔需求的快速增长。

为了进一步推动储能市场的发展，国家加强对储能行业的扶持力度。2017 年，国家能源局发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》提出在“十四五”期间，储能领域形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济

的新增长点；在细分锂离子电池领域，2017年，国家发改委、国家能源局等五部门联合印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，将100MW级锂离子电池储能系统等锂电储能技术列为具有产业化潜力的储能技术和装备。因此，锂电铜箔作为锂离子电池的主要原材料之一，未来市场需求将进一步扩大。

（3）锂电铜箔呈轻薄化趋势，超薄锂电铜箔市场前景广阔

受高能量密度动力电池补贴标准更高、有效提升续航能力以及国家政策要求等因素影响，动力锂离子电池的能量密度要求不断提高。锂电铜箔作为锂离子电池的负极材料，更薄的铜箔电阻更小，同时可降低电池重量，增加锂离子电池的能量密度。国内CATL、比亚迪、国轩等龙头电池厂商逐步采用6 μ m锂电铜箔，渗透率不断提升，通过极薄铜箔提高能量密度，寻求差异化竞争。根据研究机构测算，2019年动力电池6 μ m锂电铜箔市场渗透率仅为30%，预计2020年将达60-70%，到2023年渗透率达到100%；6 μ m锂电铜箔需求量在未来3-5年增速将在50%以上；到2023年全球6 μ m锂电铜箔需求量共约22.5万吨，市场前景广阔。

随着下游行业高速增长，对锂电铜箔产品的技术性能要求逐渐提升，为把握市场机遇，公司布局超薄锂电铜箔产业，有利于推动公司产品结构的升级。

（4）进一步扩大电子基材版图

为迎接下游行业高速发展机遇，公司推动了一系列重大项目的建设，不断夯实公司行业地位。本次非公开发行的募投项目达产后，公司将新增高频高速铜箔、超薄、极薄、高抗拉锂电铜箔等高端产品的生产能力，显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升，进一步扩大公司电子基材领域版图。

3、项目实施的可行性

（1）锂电铜箔领域的技术突破，加快推进产能释放

公司是国内最早从事电解铜箔的生产企业之一，经过多年的发展，已成功将电解铜箔产品延伸至锂电铜箔领域。目前，公司引进先进的锂电铜箔生产设备，已经实现6 μ m超薄锂电铜箔的试生产，具有行业领先的技术水平，公司生产品质保障的完备情况和工艺成熟度已经能达到进一步扩张产能的需求。通过建设年

产 10000 吨高精度超薄锂电铜箔项目，能够大幅提升公司锂电铜箔生产能力，缓解公司产能不足的压力，满足高速增长的下游客户需求，提升公司的盈利能力。

（2）深化产学研合作，为产品升级提供技术储备

公司始终秉持创新发展的理念，坚持自主创新，同时持续深化产学研合作，不断提升核心竞争力。报告期内，公司与上海交通大学签订了共建电子材料联合研究中心合作协议，双方将在高频高速（5-10G）铜箔及基板材料关键工艺技术、锂电铜箔关键工艺技术研究、大功率电子铜箔工艺技术及应用研究、先进电子产品可靠性研究等领域开展合作。报告期内，公司与嘉应学院合作研发成果“一种锂离子电池用电解铜箔的无铬免水洗防氧化液及防氧化工艺”、“一种降低电解铜箔电解液中铁离子浓度的装置及方法”完成专利申请并受理。

未来，新能源汽车将持续带动动力电池市场高速增长，锂电铜箔的需求量将保持高增长的态势。通过建设年产 10000 吨高精度超薄锂电铜箔项目，新增先进的生产设备，进一步提高公司专利技术的转化程度，充分利用公司现有研发成果，提升公司竞争力，实现价值最大化。

（3）受益于当地政府的大力支持

公司位于广东省梅州市梅县区。梅州市梅县区作为国内主要的电解铜箔生产地区之一，依托多年的生产经营经验，大力发展锂电铜箔等高发展潜力的细分版块，并不断引进其他锂电池材料、锂电池等配套产业，形成完整的锂电池产业链，为当地发展新能源汽车及高端电子产业提供支撑。2020 年 9 月，梅州市工业和信息化局草拟了《梅州市促进铜箔产业发展若干措施》（征求意见稿），提出从项目用地需求、鼓励产业整合、支持企业技术改造、鼓励企业加大研发投入、融资支持、人才支持等方面推动梅州市铜箔产业健康发展。

另外，梅州市梅县区根据当地产业发展的实际情况，对公司生产园区进行规划，计划实行产业集群战略，以引进重大企业和推动项目建设为着力点，形成产业集聚区，其中锂电铜箔、标准铜箔、覆铜板等电子新材料作为引进的重点产业，受到当地政策的大力支持。

本次非公开发行的募投项目定位于生产高精度超薄锂电铜箔，将受益于当地

政府的政策支持。

4、项目建设规划

(1) 项目实施主体

本项目实施主体为广东超华科技股份有限公司。

(2) 项目投资额

本项目总投资额为 75,000.00 万元，募集资金投资金额为 71,595.00 万元。

(3) 项目建设内容

本项目计划在广东省梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园的预留空地内，建设 10000 吨/年高精度超薄锂电铜箔生产线。建设内容包括：溶解车间、制箔车间、分切车间、水处理车间、新建厂房及装修、环保设施、企业信息化设施、总图运输等辅助生产设施。

(4) 项目建设周期

本项目建设周期为 24 个月。

5、经济效益分析

本项目建设期为 2 年，预计建设完成后第 3 年实现完全达产状态，完全达产后预计年营业收入为 80,548.00 万元，净利润为 12,159.00 万元，项目内部收益率（所得税后）为 14.65%，投资回收期（所得税后）为 5.33 年。

6、项目报批事项

本项目已分别取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2020-441403-39-03-017216），以及梅州市生态环境局出具的《关于广东超华科技股份有限公司年产 20000 吨高精度超薄锂电铜箔建设项目环境影响报告书的批复》（梅市环审[2020]8 号）。

截至本预案公告日，本项目用地正在办理相关手续。

(二) 年产 600 万张高端芯板项目

1、项目概况

公司拟投资建设年产 600 万张高端芯板项目，由全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司实施。本项目位于梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园内，为新建项目，项目总投资 37,566.00 万元。本项目通过新建厂房、引进国内外先进智能的自动化生产设备，提高公司 FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板制造能力和自动化水平。通过实施本项目，公司将新增年产量 550 万张 FR4-HDI 专用薄板产能及 50 万张高频覆铜板产能，提高公司整体竞争能力。

2、项目实施的背景和必要性

(1) 符合未来市场发展的需求方向

FR4-HDI 薄板是一种适用于 HDI 电路板并具有耐燃的覆铜板，FR4 是耐燃材料等级的代号，目前 FR4 型芯板是 PCB 行业应用领域最广泛的耐燃材料，具备广阔的市场空间。HDI（High Density Interconnector）是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板，目前广泛应用于手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能终端产品、汽车电子等，其中以手机的应用最为广泛。

高频覆铜板，即电磁频率在 1GHz 以上的特种线路板，其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高，常用于卫星接收器、基地天线、微波传输、汽车电话、全球定位系统/北斗卫星系统、通信器材转接器、接收器、信号振荡器、高速运行计算机、示波器、IC 测试仪器等，属于高频通信、高速传输、高保密性、高传送质量、高记忆容量处理等通信和计算机领域。

随着 5G 时代来临，一方面 5G 基站建设数量将大幅增加，带动高频覆铜板的发展；另一方面，5G 手机换代需求将直接提高 FR4-HDI 薄板的市场需求。

根据工信部数据，截至 2019 年我国 4G 基站数量已达到 544 万个，占基站总数的 64.7%，5G 基站数超 13 万个。伴随国内政策持续加码 5G、大数据中心等新型基础设施领域，中国三大运营商加速推进 5G 基站建设，预计在 2020 年完成 60 万个 5G 基站建设目标；同时，5G 基站将引入 Massive MIMO 技术，意味天线振子、馈电网络系统将使用更多的高频覆铜板。上述两个因素叠加，将刺激高频覆铜板的需求进一步增加。根据 Prsimark 报告显示，HDI 电路板 2019 年

-2024 年的预测年均复合增长率为 5.9%，下游行业手机、无线通信设备 2019 年-2024 年的预测年均复合增长率为 5.2% 和 8.0%，故 FR4-HDI 薄板和高频覆铜板均有较大的市场发展空间。

(2) 实现国产替代和自主供应

2018 年，我国覆铜板全年进口量为 7.95 万吨，同比减少 7.03%，进口额为 11.15 亿元，同比增长了 1.34%，全球贸易逆差约 5.2 亿美元，同比增长 3.36%，说明国产高附加值覆铜板的供给不能满足终端产品的需求，国内传统类覆铜板产能过剩，高频高速覆铜板产能不足，仍需大量进口。

目前，Rogers（罗杰斯）、松下长期垄断竞争高频高速覆铜板市场，根据兴业证券于 2019 年 12 月发布的《5G 驱动高频高速覆铜板高增长，铜箔坐享发展》研究报告，Rogers 在高频覆铜板领域全球市占率约为 60%，松下在高速覆铜板领域全球市占率约在 25-30%。公司本次募投项目将实现国产替代和自主供应能力，突破国外企业的垄断。

综上，基于制造业的转型升级、降低对国外的高频材料的进口依赖的总体趋势，国内 PCB 产业迎来加速发展高频材料的机遇。由于高频覆铜板相对传统覆铜板产品，技术壁垒更高，利润率也更高，抢先进入该市场，建立技术壁垒，能够为公司在 5G 时代的发展打下良好的基础。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具有多年覆铜板生产经验

经过近三十年的积累和创新，公司已经形成一系列成熟的企业管理体系，为公司生产经营和发展覆铜板业务提供了强有力的人才、体系的保障。同时经过多年的覆铜板生产所累积下来的工艺技术，都是确保本项目顺利实施的前提。并且公司拥有印刷电路板行业一体化布局，拥有中上游原材料的自主生产能力，为公司生产 FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板打下了良好基础。

(2) 公司具有完善的覆铜板销售团队及网络

公司凭借稳定的产品质量、准时的交货期，继续强化市场营销推广，深挖已

有市场资源，与骨干客户飞利浦、美的、欧普光电、松下、立讯精密、依顿、宏仁、胜宏科技、奥士康等多个国内外知名企业深度的战略合作。

公司通过使用销售管理移动终端平台，能够有效提升各区域销售人员沟通及管理效率。同时，公司非常重视营销队伍建设，通过建立垂直产业链上各细分市场的营销体系和对各子公司内部建立差异化的管理体系，公司整体发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，稳步推进市场开发，不断扩大市场占有率。公司完善的营销网络和队伍，是本项目实施的重要保障。

（3）完善的技术研发体系

公司与哈尔滨理工大学等研发机构成立高频覆铜板共同研发项目，成功研发“纳米纸基高频高速基板技术”项目，该项目首次创制高频高速覆铜板新技术。通过运用该新技术，在国内首次研制成功了超低介电常数和超低介质损耗的纳米纸基高频高速覆铜板，开发的纳米纸基高频高速覆铜板在应用频率目标为 10GHz 条件下，介电常数和介质损耗已达到高频高速覆铜板的技术要求；该项目总体技术水平已达到国内领先水平，填补了国内空白。该项技术成果的取得为本项目的实施和相关技术成果的产业化奠定坚实基础。

公司将继续加大技术创新投入，提升自主创新能力，并保持和高等院校、研究所的深入合作，围绕行业新技术、新产品开展深入研究，一方面提升现有产品工艺水平，降低成本；另一方面加强新产品储备，并建立有效的研究成果转化机制，增强公司内生增长动力。

4、项目建设规划

（1）项目实施主体

本项目实施主体为公司的全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司。

（2）项目投资额

本项目总投资额为 37,566.00 万元，募集资金投资金额为 32,540.00 万元。

（3）项目建设内容

本项目计划在广东省梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园的预留空地内

新建厂房，新增年产量 550 万片 FR4-HDI 专用薄板产能及 50 万片高频覆铜板产能。

（4）项目建设周期

本项目建设周期为 12 个月。

5、经济效益分析

经测算，本项目达产后预计实现年销售收入为 73,845.00 万元，达产后预计税后利润为 6,182.00 万元，内部收益率（税后）为 13.16%，投资回收期（税后）为 7.69 年。

6、项目报批事项

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010188）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 600 万张高端芯板项目环境影响报告书的批复（梅市环审[2017]28 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

（三）年产 700 万平方米 FCCL 项目

1、项目概况

公司拟投资建设年产 700 万平方米 FCCL 项目，由全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司实施。本项目位于梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园内，为新建项目，项目总投资 26,575.29 万元。本项目通过新建厂房、引进国内外先进智能的自动化生产设备，提高公司 FCCL 及覆盖膜的产能和自动化水平。通过实施本项目，公司将新增年产量 700 万平方米 FCCL 及 500 万平方米覆盖膜的产能，提高公司整体竞争能力。

2、项目实施的背景和必要性

（1）FCCL 是 PCB 行业的重要原材料

FCCL，即挠性覆铜板，是柔性电路板（FPC）的基板材料，具有轻、薄、

可挠性的特点，用 FCCL 为基板材料的柔性电路板被广泛用于智能手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。随着消费电子产品的高速发展以及 5G、数据中心等领域基建建设步伐的进一步加快，FCCL 的产量快速增长，生产规模不断扩大。

近年来，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为主的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的 FPC 市场发展。根据 PrismaMark 数据显示，2016 年全球 PCB 行业总产值 542.07 亿美元，其中 FPC 总产值为 109.01 亿美元，占比 20.11%；预计 2021 年 FPC 年产值将达到 126.41 亿美元，占比将上升至 20.92%。

FCCL 主要包括三层型（3L-FCCL）和二层型（2L-FCCL）。2L-FCCL 与 3L-FCCL 相比，具有耐温性能更好、尺寸稳定性更好、抗剥离强度更高、更加薄型化、耐折性更好等性能特点。目前，由于智能终端轻薄化的趋势越来越明显，市场对于高端 2L-FCCL 的需求量将会越来越大；与此同时，由于汽车、手机等电子产品的 FPC 仍以 3L-FCCL 为主要原材料，3L-FCCL 仍然具有较大的存量市场。

总体来说，FPC 是 PCB 行业的主要发展趋势之一，本项目实施后公司将具备 2L-FCCL 及 3L-FCCL 的生产能力，对公司顺应行业发展趋势、巩固 PCB 行业地位具有重大意义。

（2）FPC 产业中心转移，中国 FCCL 行业迎来发展契机

在全球电子信息产业向中国转移的大背景下，国内 FPC 行业迎来发展机遇。随着国际知名 FPC 厂商在中国投资设厂以及中国本土 FPC 厂商的不断发展壮大，中国逐渐成为 FPC 的主要产地，中国地区 FPC 产值占全球的比重不断提升。根据 PrismaMark 数据显示，2016 年中国 FPC 行业产值达到 46.3 亿美元，中国地区 FPC 产值占全球的比重从 2009 年的 23.7% 增至 2016 年的 42.5%。

受 FPC 产业转移的影响，我国 FPC 产值持续保持高速增长，带动基板材料 FCCL 市场的快速发展。根据中研产业研究院的研究报告显示，我国 FCCL 产量在 2015-2019 年的产值平均增长率超过 5.0%，FCCL 的产量从 2015 年的 5022 万

平方米，增长到了 2019 年的 6,647 万平方米。同时，随着国产 FCCL 产品技术含量的不断提高，进口替代率将不断上升，我国 FCCL 产业市场规模将取得进一步突破。

(3) 完善公司产业链，优化产品结构

公司坚持“纵向一体化”的产业链发展战略，目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力。目前公司的业务核心主要在刚性板领域，着手布局 FCCL 产业是公司完善柔性线路板行业产品布局的新起点，同时也是公司发掘新盈利增长点的重要举措。

3、项目实施的可行性

(1) 引进国际先进设备，生产工艺成熟

公司将从日本引进国际先进的 FCCL 生产设备，构建产能、性能达到国际水平的高端 FCCL 生产线，以保证公司生产的 FCCL 在品质上具有较强的市场竞争力。同时，公司本次 FCCL 项目将采用工艺较为成熟的层压法进行生产，以保证生产速率，保障产品质量稳定可靠。在本项目实施前，公司对生产设备及生产工艺方面已经做了充分的调研及论证，本项目实施不存在实质性障碍，具有可行性。

(2) 通过加大研发，满足 FCCL 原材料需求

FCCL 产品的主要原材料包括聚酰亚胺薄膜(PI)、热塑性聚酰亚胺薄膜(TPI)和高精度电子铜箔等。为确保公司产品质量，目前公司 FCCL 项目计划以进口原材料为主，但公司将同时加大对聚酰亚胺薄膜及热塑性聚酰亚胺薄膜的研发投入，加深公司在 FCCL 原材料领域的技术积累，为实现关键原材料的自主供给提供保证。

同时，随着下游终端应用领域对于 FCCL 轻薄的需求越来越高，厚度 9 μ m 以下的压延铜箔因受其生产工艺的限制，铜箔性能将会发生改变，难以满足 FCCL 的生产需求。因此在 9 μ m 规格以下的超薄 FCCL 领域，电解铜箔将取代压延铜箔的应用。公司已进入试产阶段的“年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程”项目（一期）中已预留部分产能用于 FCCL 专用铜箔的生产，此举将进一步保障公

司 FCCL 产品的市场竞争力以及产品稳定性，为本项目顺利实施提供了保障。

4、项目建设规划

（1）项目实施主体

本项目实施主体为公司的全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司。

（2）项目投资额

本项目总投资额为 26,575.29 万元，募集资金投资金额为 22,296.00 万元。

（3）项目建设内容

本项目计划在广东省梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园的预留空地内新建厂房，引进国际先进设备，新增 700 万平方米 FCCL 及 500 万平方米覆盖膜产能

（4）项目建设周期

本项目建设周期为 12 个月。

5、经济效益分析

经测算，本项目达产后预计实现年销售收入为 78,500.00 万元，达产首年预计税后利润为 5,932.00 万元，内部收益率（税后）为 14.15%，投资回收期（税后）为 7.94 年。

6、项目的设计报批事项的情况

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010189）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 700 万平方米 FCCL 项目环境影响报告书的批复（梅市环审[2017]29 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

（四）补充流动资金及偿还银行贷款

1、概况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中 26,300.00 万元用于补充流动资金,以满足公司生产运营的流动资金需求;拟将 27,269.00 万元用于偿还银行贷款,以提高公司偿债能力,优化资本结构。

2、项目的必要性

(1) 增强公司资本实力

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力。根据行业发展趋势及公司的业务规模,预计未来几年公司将处于快速发展阶段。市场拓展、研发投入、日常经营等环节对流动资金需求提高,公司流动资金存在一定的缺口。

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,有利于增强公司资本实力,缓解公司营运资金压力,为公司各项经营活动的开展提供资金支持,增强公司的抗风险能力。

(2) 优化公司资本结构

报告期内,公司及同行业可比公司资产负债率对比如下:

电子铜箔行业				
项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
嘉元科技(688388.SH)	7.71%	4.15%	30.59%	34.03%
诺德股份(600110.SH)	69.62%	66.54%	66.28%	62.03%
均值	38.66%	35.35%	48.44%	48.03%
覆铜板行业				
项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
建滔积层板(1888.HK)	24.08%	27.34%	37.88%	37.00%
生益科技(600183.SH)	43.57%	39.79%	46.91%	50.02%
金安国纪(002636.SZ)	38.74%	42.47%	38.87%	45.73%
均值	35.46%	36.53%	41.22%	44.25%

印刷电路板行业				
项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
深南电路（002916.SZ）	59.72%	59.06%	56.32%	57.44%
景旺电子（603228.SH）	35.21%	36.18%	42.55%	31.42%
超声电子（000823.SZ）	29.58%	30.63%	31.55%	31.27%
兴森科技（002436.SZ）	44.17%	42.96%	43.94%	44.19%
均值	42.17%	42.21%	43.59%	41.08%
超华科技	54.35%	50.55%	43.85%	44.47%

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 54.35%，高于同行业可比公司。高资产负债率对公司的融资能力、新品增长及营收规模的扩大造成了一定的制约。公司使用本次非公开发行的部分募集资金偿还银行借款后，资产负债率、流动比率、速动比率等指标将有所改善，资产负债结构得以优化，抗风险能力进一步提升。

3、项目的可行性

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合公司所处行业发展的相关政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于增强公司资本实力，优化公司资本结构，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展，实现公司发展战略。

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

三、本次非公开发行对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司的资本实力与生产规模将进一步提升，产业链将得到扩展，产品结构将得到优化。本次非公开发行将有利于公司巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

因此，本次非公开发行对公司经营管理有着积极的意义，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，将提高公司的总资产和净资产规模，通过扩产项目、补充流动资金和偿还银行贷款，公司的财务结构将得到进一步优化，资产负债结构更趋合理；同时，通过减少未来债务融资的财务费用支出，并随着扩产项目产生效益，将会进一步改善公司的财务状况和增强公司的可持续发展能力，提高未来盈利水平，公司整体实力将得到有效提升。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的竞争力和抗风险能力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

广东超华科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日